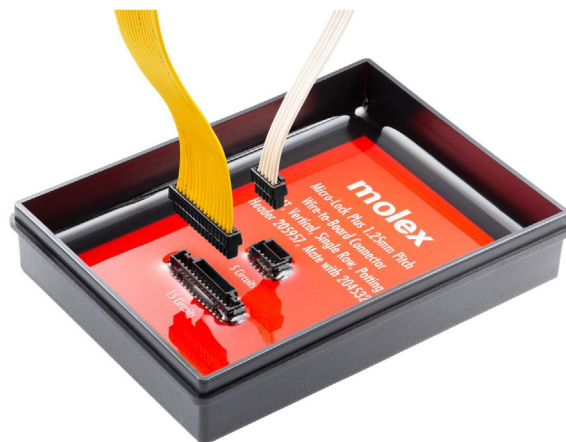




可灌封低功耗和信号垂直插座头 >

如果应用需要切实抵御湿气、冲击、震动、撞击、磨损、高温和/或化学品，则 PCB 灌封是绝佳选择。灌封能提供防潮保护，隔绝外部环境的影响，同时在锁栓区域下方预留充足间隙，以确保连接器能正确对配、拥有高保持力且稳固锁定。Molex 提供多种可灌封、低功耗和信号垂直 PCB 端板，非常适合众多应用。



PCB 端板周围的灌封化合物会硬化以形成固体屏障，从而为 PCB 端板提供额外的应力消除，以提升可靠性。

灌封材料在设备运行过程中会因热冲击条件而膨胀和收缩，从而降低焊点承受的整体应力。

灌封树脂可实现面面全覆盖，即填充 PCB 端板连接点后方原本会保持开放的区域，同时密封连接器后部，防止湿气和灰尘侵入、避免腐蚀。

灌封通常是电气和电子元件设备的理想选择，因为它可以提供额外的整体保护，同时有助于保护多种 PCB 组件免受电弧的影响。

Molex 提供特定的连接器系列，采用独特的无排水孔设计，不会干扰电气连接。

可灌封低功耗和信号垂直插座头 >

从下表所示、具有灌封功能的产品家族中进行选择。
所示高度是从印刷电路板 (PCB) 表面测量的高度。
如需更多信息, 请查看应用规格。

产品家族	间距 (MM)	系列号	最大灌封高度 (MM)	灌封应用规格
Micro-Lock Plus 连接器	1.25	205957、207760	3.00	查看规格 (英语和日语)
Spot-On 连接器	1.50	201648、201645、201646	5.00	查看规格 (英语)
	2.0	201201、201197	7.00	查看规格 (英语)
Micro-One 连接器	2.0	217063	7.00	查看规格 (英语和日语)
Mini-Lock 连接器	2.50	53517	6.00	查看规格 (英语和日语)
Nano-Fit 连接器	2.50	105312、105310	4.00	查看规格 (英语)
Micro-Fit 连接器	3.0	44432	4.10	查看规格 (英语)
Micro-Fit+ 连接器	3.0	206832	3.45	查看规格 (英语)
CP 连接器	3.00	212210	7.50	查看规格 (英语和日语)
Ultra-Fit 连接器	3.50	172299、172298	6.55	查看规格 (英语)
Mini-Fit 连接器	4.20	5566、172447	5.50	查看规格 (英语)
Mini-Fit Max 连接器	4.20	212520	6.67	查看规格 (英语)
Mega-Fit 连接器	5.70	76829、172065	7.26	查看规格 (英语)